

製品仕様書  
PRODUCT  
SPECIFICATION

---

*6810Series*

0.5 mm pitch FPC/FFC connector

京セラ株式会社  
KYOCERA Corporation

C	DCN21238	2021/03/24	Y. Manba		Y. Fujii
B	DCN20066	2020/01/21	N. Nakajima	Y. Manba	Y. Fujii
O	EDN-485	2014/09/09	N. Nakajima		Y. Fujii
NO	EDN/DCN	DATE	PREPARED by	CHECKED by	APPROVED by

1. 品名 FPC/FFC Connector

2. 形式 0.5 mm pitch FPC/FFC connector (Au plated)

3. 適用範囲 Scope

本仕様書は 6810 シリーズコネクタの組立製品の仕様に適用する。

This specifies 6810 Series 0.5 mm pitch FPC/FFC connector.

4. 関連規格 Related documentation

・IEC 60512-1-100:2002 電子機器用コネクタ-試験及び測定- 第 1-100 部:一般-試験一覧

Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-

Part 1-100:General-Applicable publications

・JIS C 5402-1-100:2002 電子機器用コネクタ-試験及び測定- 第 1-100 部:一般-試験一覧

Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-

Part 1-100:General-Applicable publications

・JIS-C-5402:1992 電子機器用コネクタの試験法

Method for Test of Connectors for Electronic Equipment.

5. 形状、寸法、及び材料 Configuration, Dimension, and Material

図面参照 Refer to drawings.

6. 製品型番 Part numbering

04 6810 6XX 0XX 846 +

バリエーション VARIATION

0 : ST TYPE + with GND CONTACT

1 : RA TYPE + with GND CONTACT

2 : ST TYPE + without GND CONTACT

3 : RA TYPE + without GND CONTACT

バリエーション VARIATION

0 : 通常タイプ THE USUAL KIND

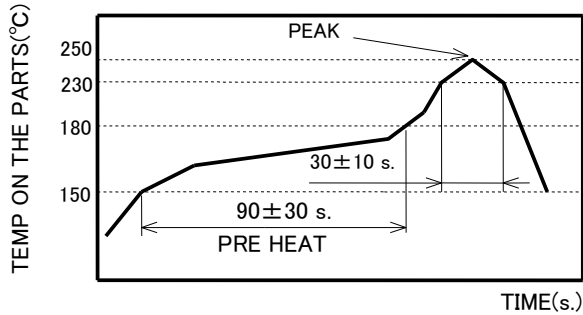
1 : コンパクトタイプ THE COMPACT TYPE

極数 No. of pos.

## 仕様 Spec

## 嵌合状態において、Under mating condition

		項目 Item	条件・方法 Condition	規格 Specification	
7.一般 General	1	定格電流 Current rating	—	DC 0.4 A/contact	
	2	定格電圧 Voltage rating	—	DC 50 V/contact	
	3	使用温湿度範囲 Operation environment	—	-40°C ~ 85°C 95% MAX. 低温に於いて氷結しないこと。 結露しないこと。 通電による温度上昇分も含む。 Ice-free at the low temperature. No condensation shall occur. Including terminal temperature rise. Humidity 95 % MAX.	
	4	保存温湿度範囲 Storage environment	梱包状態にて While packed	-20°C ~ 60°C 75% MAX. 低温に於いて氷結しないこと。 結露しないこと。 Ice-free at the low temperature. No condensation shall occur.	
8.機械的 Mechanical	1	外観 Appearance	目視 Visual inspection	機能に有害なサビ、汚れ、キズ、変形等のないこと。 No rust, contamination, damage or deformation effecting on function.	
	2	FPC/FFC 挿入力 FPC/FFC insertion force	25mm/min. / 10 times	初回 Initial	0.76 N MAX./pin
				10 回後 10 times	0.76 N MAX./pin
	3	FPC/FFC 抜去力 FPC/FFC separation force	25mm/min. / 10 times	初回 Initial	0.09~0.76 N/pin
				10 回後 10 times	0.09~0.76 N/pin
	4	コンタクト保持力 Contact retention force	25mm/min.	0.1 N MIN.	
	5	挿抜耐久性 Durability	無通電状態で without Current applied 10 times/min. 10 times	外観 Appearance 素地の露出がないこと。 Conductor shall not be exposed. 接触抵抗 Contact resistance 100mΩ MAX.	
	6	FPC/FFC 保持力 FPC/FFC retention force	25mm/min. / 10 times	0.09×n N MIN. n: 極数 No. of pos.	
	7	振動 Vibration	10~55~10 Hz/min. /1.5mm (peak to peak) /DC 100mA (2h per direction; XYZ, 6h in total) IEC 60068-2-6:1995 JIS C 60068-2-6:1999	瞬断 Discontinuity 1μs MAX. 外観 Appearance 機械的破損、部品のゆるみクラック等ないこと。 No damage, loose part or crack. 接触抵抗 Contact resistance 100 mΩ MAX.	

	8	衝撃 Shock	50G / 11ms /DC 100mA (3times per direction; XYZ) <b>IEC 60068-2-27:1972</b> <b>JIS C 60068-2-27:1995</b>	瞬断 Discontinuity 1 $\mu$ s MAX. 外観 Appearance 機械的破損、部品のゆるみクラック 等ないこと。 No damage, loose part or crack
	9	はんだ付性 Solder ability	245 $\pm$ 3 $^{\circ}$ C / 3 $_{-1}^{0}$ sec. immersion <b>IEC 60068-2-20:1979</b> <b>JIS C 60068-2-20:1996</b>	浸漬部にはんだが 95%以上 More than 95% of immersed area shall be covered with solder.
	10	はんだ耐熱性 Resistance to solder heat	<p>&lt;手はんだ Hand soldering&gt; はんだごて温度 Bit temperature 350<math>\pm</math>10<math>^{\circ}</math>C 3 <math>_{0}^{+1}</math> sec. <b>(Modified) IEC 60068-2-58:1999</b> <b>JIS C 60068-2-58:2002</b></p> <p>&lt;リフロー Reflow&gt; 下記プロファイル参照 See the following condition リフローは 2 回まで可 Number of cycles: 2 times ※ただし、2 回目は常温に戻す事 Second reflow process must be conducted after the product temperature has down to the room condition. ピーク PEAK: 250<math>^{\circ}</math>C (コネクタ表面) (On the surface connector)</p>	端子ガタ、変形等ないこと。 There shall be no damage on appearance. Electrical characteristics and mechanical characteristics shall be satisfied.
				
9.電氣的 Electrical	1	耐電圧 Dielectric withstanding voltage	AC 200V、1min. (Leak 2mA) <b>JIS C 5402 (5.1):1992</b>	フラッシュオーバー、スパークオーバー、 絶縁破壊ないこと。 No flashover, spark over dielectric breakdown
	2	絶縁抵抗 Insulation resistance	DC 100V、1min. <b>JIS C 5402 (5.2):1992</b>	100M $\Omega$ MIN.
	3	ローレベル接触抵抗 Low level contact resistance	四端子法にて Four probe method <b>JIS C 5402(5.3):1992</b>	50m $\Omega$ MAX.

	4	温度上昇 Temperature rise	嵌合状態でコンタクトを直列に結線 Under mating condition, all contacts shall be connected serially. JIS C 5402 (5.10):1992	定格電流にて 30K MAX. at the Current rating		
10.耐環境 Environment	1	二酸化硫黄 SO <sub>2</sub>	40℃ / 75% / 3±1ppm / 96h IEC 60068-2-42:1976 JIS C 60068-2-42:1993	接触抵抗 Contact resistance 100mΩ MAX.		
	2	塩水噴霧 Salt mist	5±1weight%/35±2℃ /48±4h IEC 60068-2-11:1981 JIS C 60068-2-11:1989	接触抵抗 Contact resistance 100mΩ MAX.		
	3	温度サイクル Temperature cycling	5 cycles (Modified) IEC 60068-2-14:1984、 -33:1971 JIS C 0025:1988	接触抵抗 Contact resistance 100mΩ MAX. 外観 Appearance 異常がないこと Without distinct damage.		
			段階 Step		温度(℃) Temperature	時間(分) Time(min.)
			1		-55±3	30
			2		25± <sup>10</sup> <sub>5</sub>	10～15
			3		85±2	30
4	25± <sup>10</sup> <sub>5</sub>	10～15				
4	高温加速(寿命) High temperature(Life)	85±2℃ / 96h IEC 60068-2-2:1974 JIS C 60068-2-2:1995	接触抵抗 Contact resistance 100mΩ MAX.			
5	耐寒性 Cold resistance	-40±3℃ / 48h IEC 60068-2-1:1990 JIS C 60068-2-1:1995	接触抵抗 Contact resistance 100mΩ MAX.			
6	湿度(定常) Moisture resistance	40±2℃ / 90～95% / 96h IEC 60068-2-3:1969 JIS C 60068-2-3:1987	接触抵抗 Contact resistance 100mΩ MAX. 絶縁抵抗 Insulation resistance 100MΩ MIN. 耐電圧 Dielectric withstanding voltage フラッシュオーバー、スパークオーバー 絶縁破壊ないこと。 No flashover, spark over, dielectric breakdown			

## 取り扱い注意事項 Precautions

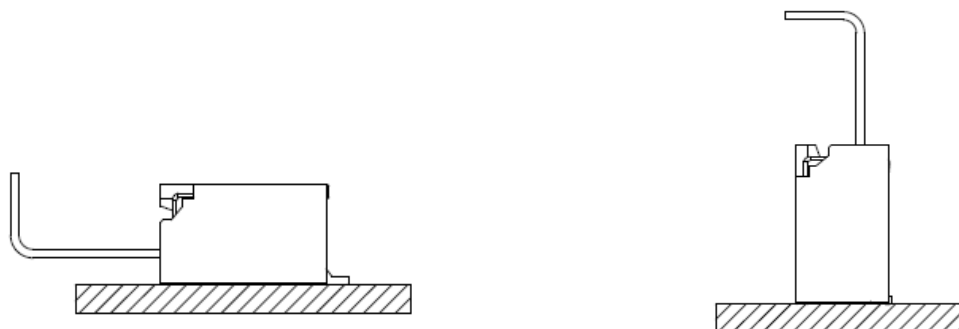
### 1 FPC/FFC の屈曲について Flexion of FPC/FFC

FPC/FFC の屈曲によりコネクタ接点部に過剰な負荷がかからないようにご注意ください。

尚、FPC/FFC をコネクタのカード挿入口近くで繰り返し屈曲させ使用する場合は、ご相談ください。

条件によっては弊社にて評価確認を行います。

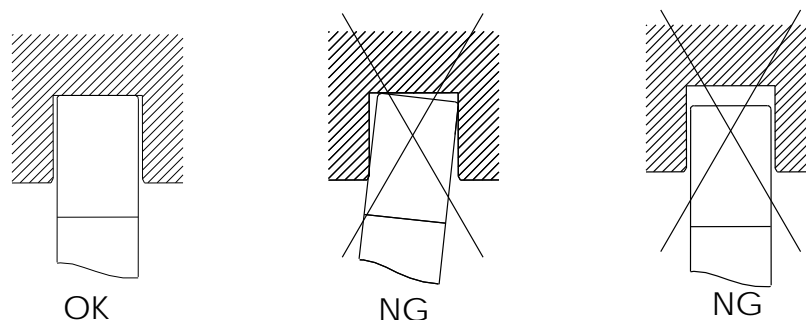
Pay attention not to apply an excess load to contacts of the connector because of the flexion of FPC/FFC. Please contact us when your FPC/FFC have to be bent repeatedly near the opening for card insertion. Depending on conditions, evaluation and verification shall be conducted by us.



### 2 FPC/FFC の挿入について FPC/FFC insertion and separation

FPC/FFC はカードスロット底面に当てられるまで垂直に挿入して下さい。

Insert the FPC/FFC vertically until it hits to the slot end.

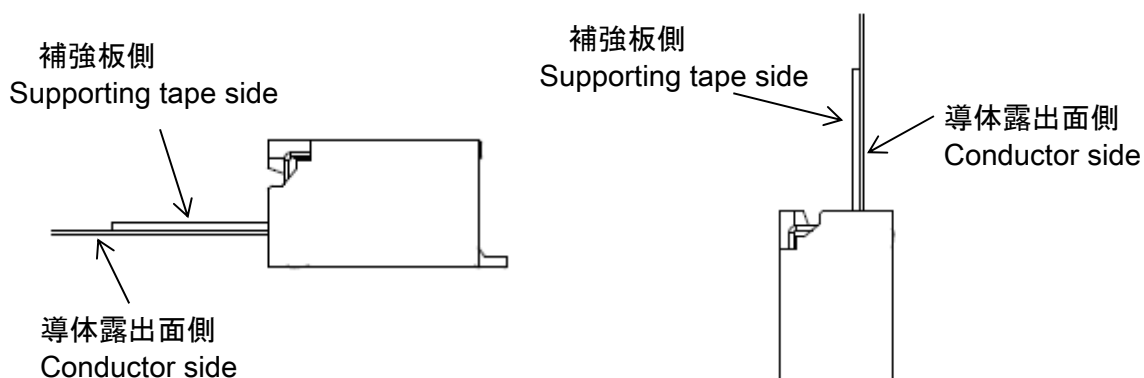


検査工程等で FPC/FFC の挿抜を行う際は、最終組込み用 FPC/FFC よりも薄い FPC/FFC を使用願います。  
For the FPC/FFC insertion and separation in the inspection process, please use thinner FPC/FFC than those for final assembling.

### 3 FPC/FFC の方向性 Direction of FPC/FFC

図のように導体露出面を下にし、補強板が下図と同じになるように装着して下さい。

FPC/FFC shall be inserted as shown below with conductor side down and supporting tape side up.



#### 4 FPC/FFC 保持力について FPC/FFC retention force

嵌合状態の FPC/FFC を無理に引き抜いた場合、コネクタ及び FPC/FFC が破損する可能性がある為、無理な引き抜きはなさないよう御願致します。

If the mated FPC/FFC is forcibly pulled out, the connector or the FPC/FFC may be damaged.  
Please do not pull it out forcibly.

#### 5 アクチュエータ操作 Actuator operation

コネクタの破損防止の為、アクチュエータ操作は基板に半田付け後行うようにして下さい。

After soldering, a actuator shall be operated to prevent damage to a connector.

#### 6 活線挿抜について Hot Swap

本製品に電流を流した状態での挿抜は、なさないよう御願致します。

Insertion and separation under live current shall not be done.

#### 7 その他

7-1. 本製品の樹脂部に黒点・変色等が確認される場合がありますが、製品性能には影響はございません。

Although there may be some small dark spots or discoloration on this product, the product performance will not be affected.

7-2. 樹脂のウェルド部に線が確認される場合がありますが、製品仕様書、取扱説明書の範囲での使用に於いて、性能に影響はございません。

Although a line may appear on the welded part on the housing, it dose not affect on connector performance as long as the connector is used according to the specification and the instruction manual.

7-3. 実装後におきまして本製品のめっき部に変色等が確認される場合がありますが、製品性能には影響はございません。

Although the plated areas may be discolored after mounted, it does not adversely affect the product performance.

7-4. 本製品の実装エリアへのシルク印刷は、コネクタ本体がシルク印刷上に乗り上げ実装不良等の原因となることがある為、避けて頂きますようご配慮願います。リフロー加熱によりインシュレータ外表部にふくれが発生する場合がありますが FPC/FFC の挿入及びコンタクトの可動を妨げるものではなく実使用上問題はありせん。

It shall be prohibited to apply silkscreen printing to the area on the board where this connector is mounted, because the connector running on the silkscreen printing may cause a mounting failure. Although blisters may be formed due to the reflow heat, it will not interfere with the movability of contacts, so there is no practical problem.

7-5. 本製品は FPC 基板への実装は推奨しておりません。

This product is not recommended for mounting on FPC board.

## 特記事項 Special Instructions

弊社は、本製品が本仕様書に適合していることを保証します。なお、以下の事項につきましては貴社と協議の上で対応させていただきます。

It is assured by us that the products conform to this specification. Nevertheless, the following matters will be determined after due consultation with you.

- (1) 本製品については、本仕様書に記載された内容にもとづいて弊社が責任を負うものです。従いまして、本仕様書に記載のない事項、特に納入に際し配慮すべき事項等がある場合は、その旨、ご指示を頂き、貴社との協議を経て本仕様書を修正し、再発行致します。

Based on the contents written in this specification, we shall be liable for the products. If there are any particulars or matters that are not described herein, especially cautions or notes to be considered when the products are delivered, please give such advices to us. The specification will be modified as required and re-published after due consultation with you.

- (2) 本製品の貴社への納入後、万一本製品に弊社責任による不具合の存在があきらかになった場合、貴社と弊社間で取引基本契約書を締結している場合は、瑕疵担保責任条項に従って履行します。また当該契約書を締結していない場合は、代替品の納入、不具合品の交換、または修理を行います。

If a problem arising from our failure comes clear on products after they are delivered to you, we implement the defect liability provision in the basic contact document if when both of us entered into the document. When any basic contact document is not entered into by us, we will deliver substitutive products, or replace or repair defective products.

- (3) 以下の場合については、本製品の保証をご容赦願います。

Please acknowledge that the products are not warranted in the following cases.

1. 本製品の貴社への引渡し後、製品の取扱い、保管、運搬(輸送)において本仕様書に規定する条件外の条件が加わった事が証明された場合。

If it is proved that the products were subjected to any conditions other than those provided in this document in handling or storage and during transport after the products have been delivered to you.

2. 地震、洪水、火災等の天災地変あるいは輸送機関の事故、争議、戦争等不可抗力に起因する本製品の不具合。

Any product failure due to natural disasters such as earthquake, flood, fire or else, or force majeure such as transport accident, dispute, war or etc.

## 有害物質の規制遵守について Conformance to restrictions of hazardous substances

本製品には以下の物質を含有しておりません。さらに製造工程に於いても使用しておりません。

The following substances are not included in this product or used in production processes.

オゾン層破壊物質 Ozone depleting substances

特定臭素系難燃剤 Specific brominated substances, PBBP, BDE

重金属 Heavy metals

水銀、カドミウム、六価クロム、鉛

Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Lead

疑義が生じた場合は、和文を優先する。

Priority shall be given to the expression written in Japanese when any unclearness arises in this specification.